



全球观察-LAM: 4Q22 营业收入略高于指引中值 供应链紧张情况有所缓解



行业近况

1月25日, LAM 公布 FY2Q23 (CY4Q22) 业绩并召开业绩说明会: 公司 FY2Q23 实现营业收入 52.78 亿美元, QoQ+4%, 毛利率达 45.1%, QoQ-90bps, 营业利润达 16.95 亿美元, QoQ+0.4%, 略高于指引中值。

评论

LAMFY2Q23 收入端环比增长, 毛利率有所下滑: FY2Q23 收入端达 52.78 亿美元, QoQ+4%, 其中半导体系统收入约 35.5 亿美元, QoQ+12%, 主要受益于更多刻蚀和沉积设备的发货, CSBG 业务收入达 17.3 亿美元, QoQ-9%, 下滑主要原因为下游产能利用率的下滑以及设备支出的减少; 毛利率达 45.1%, QoQ-90bps, 主要原因为产品及客户组合的变化 (美国出口新规后对于中国大陆客户设备购买的限制), 略高于指引中值。营运费用达到 6.86 亿美元, QoQ+6%, 主要来源于研发费用的增长, 营运利润为 16.95 亿美元, 环比基本持平, 营运利润率为 32.1%, QoQ-120bps, 主要受毛利下滑影响。

公司管理层预计 2022 年晶圆制造设备支出在 950 亿美元左右, 2023 年或将同比下滑约 20%, 位于 750 亿美元左右。其中主要原因为 NAND 及 DRAM 库存处于高位, 存储制造商下调资本开支及产能利用率以实现库存去化, 同时 2022 年 10 月美国政府出台的出口新规对于中国大陆晶圆厂的资本开支也将产生负面影响。受到需求端的下滑, 公司预计将裁去 1,300 名员工, 约占总员工数量的 7%, 同时将在下个季度产生接近 8000 万美元

的费用，在未来 12 个月内合计产生接近 1.5~2.5 亿美元的费用。

供应链紧张趋势缓解，递延收入逐步下滑：FY2Q23 公司递延收入达 20 亿美元，环比下降 7.7 亿美元，公司管理层表示供应链带来的限制正逐步改善，公司正逐步满足收入确认所需要的关键部件的发货，同时预计下一季度递延收入有望恢复至正常水平。

公司给出 FY3Q23 业绩指引：管理层预计收入端达 38 亿美元 (± 3 亿美元)，毛利率达 44% ($\pm 1\%$)，运营利润率达 27.5% ($\pm 1\%$)，稀释后每股收益达 6.5 美元 (± 0.75 美元)，股本数量达 1.35 亿股。

风险

晶圆厂资本开支进一步下降，中美贸易摩擦加剧，先进技术研发不及预期。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51618

